

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

芯智控股有限公司 Smart-Core Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2166)

關連交易 貸款協議的補充協議及 提供財務資助

補充協議

於2019年8月13日，芯智國際與銘冠訂立有關貸款協議的補充協議，以修訂及重述貸款協議的條款。

上市規則涵義

於本公告日期，本公司的全資附屬公司Smart IC Cloud持有銘冠25%已發行股本。燕先生為本公司執行董事，因而為本公司關連人士。彼亦為銘冠的主要股東。因此，銘冠被視為上市規則第14A.27條所界定的共同持有實體。

芯智國際向銘冠作出的經修訂融資(如補充協議所載)構成上市規則第14A.26條下本公司的一項關連交易。由於有關經修訂融資的最高適用百分比率(定義見上市規則)不超過5%，因此經修訂融資須遵守上市規則第14A.76(2)條下的申報及公告規定，但獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及股東批准規定。

由於燕先生為本公司的關連人士(如上文所披露)及李先生為銘冠的主要股東，因此，根據上市規則，個人擔保(燕青)及個人擔保(李紅勝)以財務資助的形式各自構成本公司的關連交易。根據上市規則第14A.90條，由於董事認為有關財務資助乃按一般商業條款或更佳條款進行，且毋須以本集團資產作抵押，故本集團收取的有關財務資助獲完全豁免遵守上市規則第14A章下的申報、公告及獨立股東批准規定。

背景

提述本公司日期為2019年5月28日的公告(「該公告」)，內容有關芯智國際與銘冠訂立的貸款協議，據此，芯智國際同意向銘冠提供總額為2,500,000美元年利率為7%的美元循環貸款融資。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

補充協議

於2019年8月13日，芯智國際與銘冠訂立補充協議，以修訂及重述貸款協議的條款。補充協議的主要條款及條件載列如下：

日期： 2019年8月13日

訂約方： (1) 本公司的全資附屬公司芯智國際(作為貸方)；及
(2) 銘冠(作為借方)。

持續義務： (1) 貸款協議將保持十足效力及作用；
(2) 儘管簽署補充協議，銘冠於貸款協議下的義務和責任將不會解除或減少；及
(3) 補充協議的任何內容均不構成或被解釋為豁免或解除芯智國際於貸款協議下的任何權利或補救措施，亦不損害芯智國際於貸款協議下的任何權利或補救措施。

建議修訂及重述： 請參閱下文「建議修訂及重述」一節

建議修訂及重述

根據補充協議，以下情況自生效日期起生效(i)貸款協議將予以修訂及重述，以便按照補充協議附表所載的所有目的予以解讀及解釋；及(ii)貸款協議將經補充協議予以修訂及／或補充，以便對當中「貸款協議」的所有提述均應解讀及解釋為對不時經修訂及補充的貸款協議(包括補充協議)的提述。

下文為貸款協議與經修訂貸款協議之間主要條款及條件差異的比較：

	貸款協議	經修訂貸款協議
芯智國際同意向銘冠提供美元 循環貸款融資總額	2,500,000美元	3,800,000美元
有效期限	貸款協議日期至2019 年9月29日(包括 該日)期間	經修訂貸款協議日期 至2020年3月30日 (包括該日)期間
到期日	2019年9月30日	2020年3月31日

除上述者外，經修訂貸款協議載列的所有其他主要條款及條件與貸款協議的所有其他主要條款及條件相同。

個人擔保

為保證償還或彌償擔保義務，燕先生及李先生各自於2019年8月13日分別訂立個人擔保(燕青)及個人擔保(李紅勝)，據此，燕先生及李先生各自不可撤銷及無條件地(其中包括)向芯智國際擔保各其他債務人準時履行所有擔保義務，並承諾，但凡另一名債務人未有支付擔保義務到期應付的任何款項，其將即時應要求支付有關款項，猶如其為主要債務人。

先決條件

以下先決條件達成後，貸款協議的修訂及重述將於生效日期當日起生效：

1. 芯智國際收到銘冠董事會會議記錄副本或簽署補充協議的類似授權及與補充協議相關的所有附屬文件；
2. 芯智國際及銘冠各自正式簽署補充協議；
3. 各訂約方正式簽署個人擔保(李紅勝)；
4. 各訂約方正式簽署有關個人擔保(李紅勝)的警告通知；

5. 各訂約方正式簽署個人擔保(燕青)；
6. 各訂約方正式簽署有關個人擔保(燕青)的警告通知；
7. 芯智國際收到其可能合理要求的有關其他文件及信息。

訂立補充協議的理由及裨益

銘冠正擴大其作為電子元件分銷商的業務營運。為確保該穩定增長將得到足夠財力支持，銘冠將需額外現金流量撥付因其客戶訂單所產生的商品採購訂單。據估計，銘冠對此類額外現金流的需求將更大，持續時間比此前預期更長。因此，於銘冠與本公司公平磋商後，本公司同意透過芯智國際訂立補充協議。

董事(包括獨立非執行董事)認為，雖然訂立補充協議並非於本集團的一般及日常業務過程中進行，但補充協議的條款(由本公司與銘冠公平磋商後訂立)屬一般商業條款，且有關條款公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

燕先生為執行董事兼銘冠的主要股東。彼被視為於根據補充協議擬進行的交易中擁有權益，並已放棄就批准補充協議的相關董事會決議案投票。除上述者外，概無董事於根據補充協議擬進行的交易中擁有權益，且彼等毋須就批准補充協議的相關董事會決議案放棄或已經放棄投票。

有關銘冠的資料

銘冠為一間根據香港法例註冊成立的私人股份有限公司。銘冠連同其全資附屬公司蘇州酷科為領先的電子元件分銷商。銘冠及蘇州酷科的大部分客戶位於亞洲，惟銘冠亦向跨國公司客戶提供服務及產品。銘冠的其中一項核心業務為逆向供應鏈管理服務，倘客戶出現市場供應短缺，為其提供相關解決方案。銘冠亦擅於通過高效、敏銳的方式處理客戶的多餘存貨，協助彼等在全球範圍內經營OEM/EMS業務。銘冠由Smart IC Cloud、燕先生、李紅勝、Ng Teck Yee (Jason)及倪莉分別擁有25%、22.5%、22.5%、22.5%及7.5%，而銘冠為本公司的附屬公司，因為根據相關會計政策，銘冠的財務業績綜合於本集團的綜合財務報表內。詳情請參閱本公司日期為2018年10月22日的公告。

有關集團的資料

本集團是一家在中華人民共和國本土領先的集成電路及其他電子元器件分銷商及技術增值服務商。本集團與全球知名的電子元器件供應商保持長期及穩定的合作關係，亦擁有忠誠及多元化的客戶群。此外，本集團提供的技術支持服務亦協助本集團與供應商與客戶保持共生關係。本集團在智能媒體顯示、智能廣播終端和存儲器這三個產品線保持著行業領先地位，在光學通訊、安防監控、觸控、電子汽車以及物聯網等領域的業務開始實現規模銷售。芯智國際的主要業務為電子元器件貿易，並為本公司的主要附屬公司之一。

上市規則涵義

於本公告日期，本公司的全資附屬公司Smart IC Cloud持有銘冠25%已發行股本。燕先生為本公司執行董事，因而為本公司關連人士。彼亦為銘冠的主要股東。因此，銘冠被視為上市規則第14A.27條所界定的共同持有實體。

芯智國際向銘冠作出的經修訂融資(如補充協議所載)構成上市規則第14A.26條下本公司的一項關連交易。由於有關經修訂融資的最高適用百分比率(定義見上市規則)不超過5%，因此經修訂融資須遵守上市規則第14A.76(2)條下的申報及公告規定，但獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及股東批准規定。

由於燕先生為本公司的關連人士(如上述所披露)及李先生為銘冠的主要股東，因此，根據上市規則，個人擔保(燕青)及個人擔保(李紅勝)以財務資助的形式各自構成本公司的關連交易。根據上市規則第14A.90條，由於董事認為有關財務資助乃按一般商業條款或更佳條款進行，且毋須以本集團資產作抵押，故本集團收取的有關財務資助獲完全豁免遵守上市規則第14A章下的申報、公告及獨立股東批准規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「經修訂融資」	指	根據經修訂貸款協議協定總額為3,800,000美元的美元循環貸款融資
「經修訂貸款協議」	指	經修訂及重述的貸款協議，以便按照補充協議附表所載的所有目的予以解讀及解釋
「生效日期」	指	補充協議所載先決條件獲達成使芯智國際信納的日期
「擔保義務」	指	債務人根據或有關任何財務文件（包括經修訂貸款協議、個人擔保（燕青）、個人擔保（李紅勝）及芯智國際及銘冠指定的任何其他文件）欠付芯智國際或所產生的一切現時及未來應付款項、債務、承擔及負債（於各情況下均不論是否獨立或聯合、或與其他人士共同及個別作出，亦不論為實際或可能作出，或作為當事人或擔保人或以其他身份作出）
「貸款協議」	指	芯智國際與銘冠所訂立日期為2019年5月28日的2,500,000美元循環貸款融資協議
「李先生」	指	李紅勝，為中華人民共和國公民及銘冠的主要股東
「燕先生」	指	燕青，為新加坡共和國公民，及為執行董事
「債務人」	指	銘冠、燕先生及李先生，各自稱「 債務人 」
「個人擔保（李紅勝）」	指	李先生（作為擔保人）為芯智國際提供的個人擔保
「個人擔保（燕青）」	指	燕先生（作為擔保人）為芯智國際提供的個人擔保

「銘冠」	指	銘冠國際香港有限公司，根據香港法例註冊成立的私人股份有限公司，於本公告日期由本公司持有25%
「芯智國際」	指	芯智國際有限公司，根據香港法例註冊成立的私人股份有限公司，為本公司全資附屬公司
「Smart IC Cloud」	指	Smart IC Cloud Holdings Limited，根據英屬處女群島法律正式成立及有效存續的公司，為本公司全資附屬公司
「補充協議」	指	芯智國際與銘冠於2019年8月13日訂立有關貸款協議的補充協議（其於附表中載列（其中包括）經修訂貸款協議）

承董事會命
芯智控股有限公司
 董事長及執行董事
田衛東

香港，2019年8月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事田衛東先生（董事長）、黃梓良先生、劉紅兵先生及燕青先生，獨立非執行董事鄭鋼先生、湯明哲先生及王學良先生。